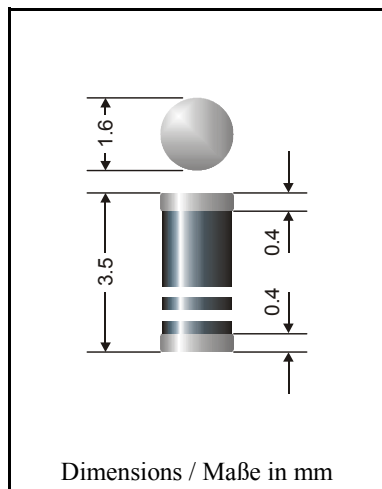


Ultrafast Switching
Surface Mount Si-Rectifiers
Ultraschnelle Si-Gleichrichter
für die Oberflächenmontage


Nominal current – Nennstrom	0.5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...400 V
Plastic case MiniMELF Kunststoffgehäuse MiniMELF	SOD-80 DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	see page 18 siehe Seite 18

- Marking:
1. green ring denotes “cathode” and “ultrafast switching device”
 2. colored ring denotes “repetitive peak reverse voltage” (see below)
- Kennzeichnung:
1. grüner Ring kennzeichnet “Kathode” und “ultraschneller Gleichrichter”
 2. farbiger Ring kennzeichnet “Period. Spitzensperrspannung” (siehe unten)

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Rep. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	2. Cathode ring 2. Kathodenring
EGL 34A	50	50	gray / grau
EGL 34B	100	100	red / rot
EGL 34D	200	200	orange
EGL 34F	300	300	brown / braun
EGL 34G	400	400	yellow / gelb

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last	$T_T = 75^\circ\text{C}$	I_{FAV}	0.5 A
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwell	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	10 A
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	0.5 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	- 50...+175 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	- 50...+175 °C

Characteristics

Kennwerte

Type Typ	Reverse recovery time Sperrverzugszeit t_{rr} [ns] ¹⁾	Forward voltage Durchlaßspannung V_F [V] at / bei I_F [A]
EGL 34A ... EGL 34D	< 50	< 1.25
EGL 34F ... EGL 34G	< 50	< 1.35

Leakage current
Sperrstrom

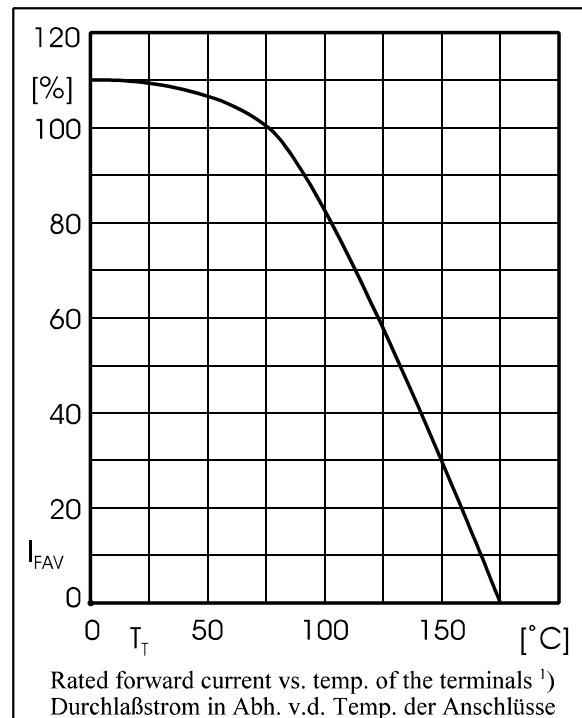
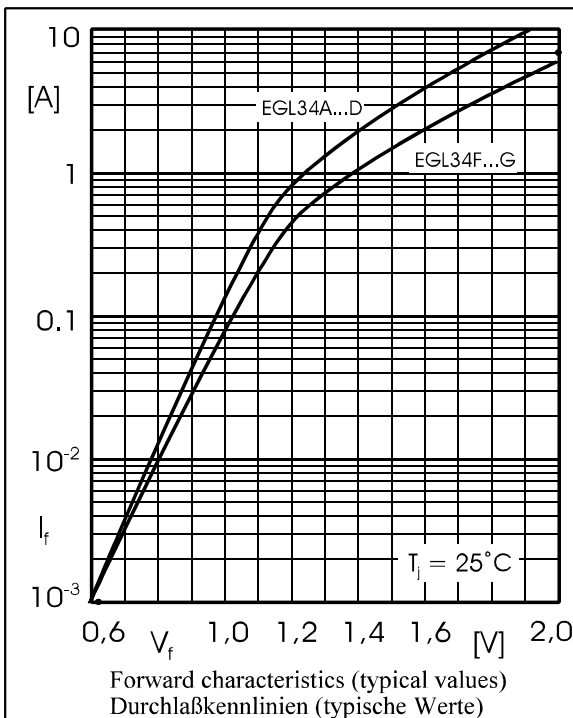
$T_A = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 5 μA
$T_A = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	< 50 μA

Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft

R_{thA} < 150 K/W ²⁾

Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Kontaktfläche

R_{thT} < 70 K/W



¹⁾ $I_F = 0.5$ A through/über $I_R = 1$ A to/auf $I_R = 0.25$ A

²⁾ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß